

目录

特性参数.....	2
亮度分档.....	2
显指分档.....	2
电压分档.....	3
色区分档.....	3
光电性能特征曲线.....	4
出货编码规则.....	5
产品尺寸.....	6
包装规格.....	6
回流焊曲线.....	8
注意事项.....	10

产品特征

规格: 1.8 mm×6.0 mm
倒装结构陶瓷封装
典型光通量 (85℃)
700mA: 795lm

应用

城市亮化
商业照明
汽车照明

特性参数 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$)

项目	单位	最小值	典型值	最大值
发光角度	degrees ($^\circ$)	--	120	--
直流正向电流	mA	--	700	1500
反向电压	V	--	--	5
正向电压	V	8.5	9.0	9.7
LED 结温	$^\circ\text{C}$	--	--	150

亮度分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$)

编号	光通量范围 (lm)
F2	680~730
F4	730~780
G2	780~840
G4	840~900

备注：亮度测试误差 $\pm 7\%$

显指分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$)

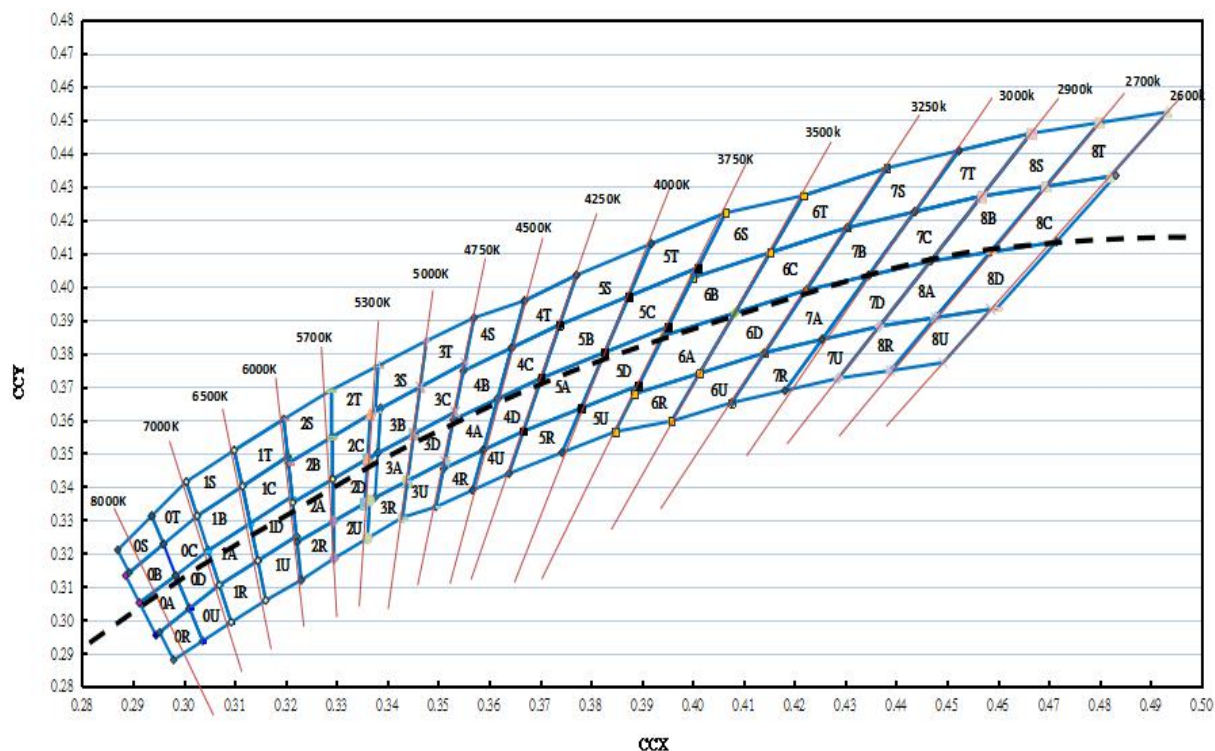
级别	范围
B0	70~100

电压分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$)

编号	电压范围 (V)
VS	8.5~8.8
VH	8.8~9.1
VJ	9.1~9.4
VK	9.4~9.7

备注：电压测试误差 $\pm 0.1\%$

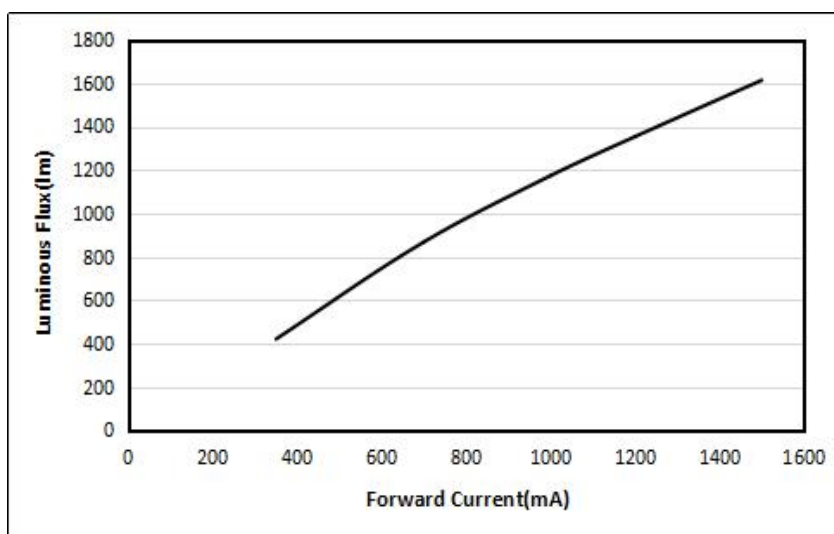
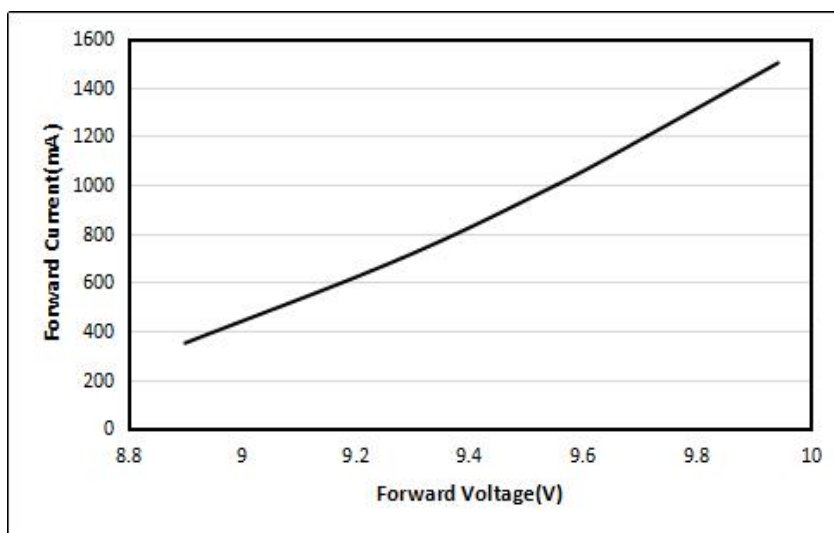
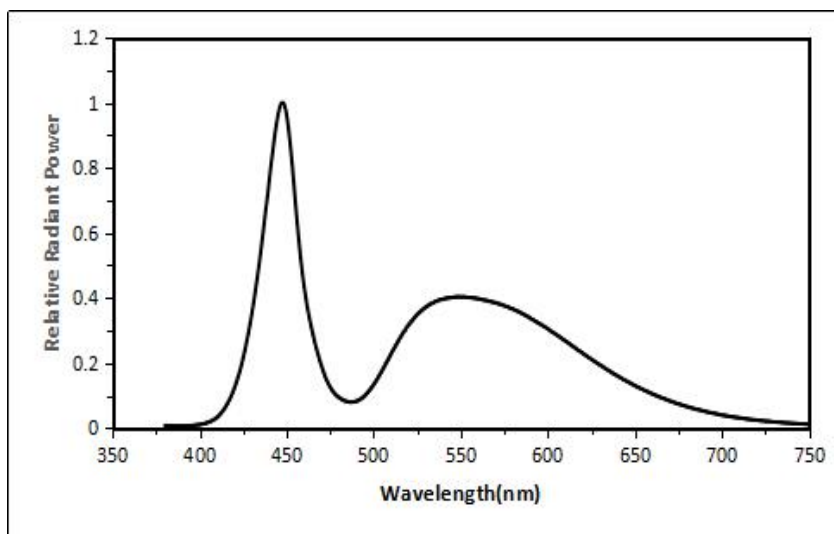
色区分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$)

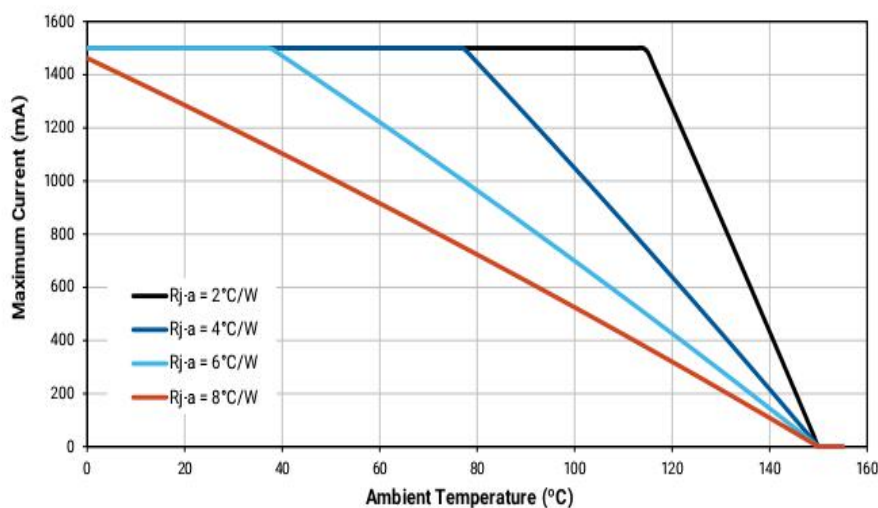
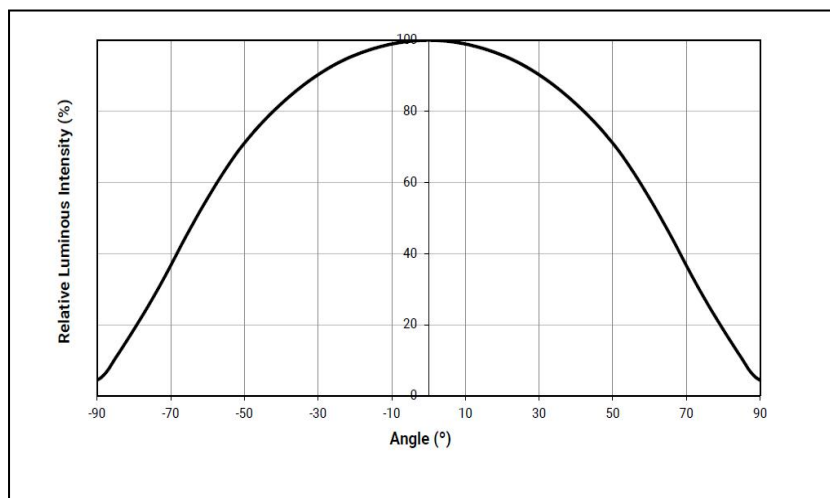


备注：色区 (CCx, CCy) 尺寸误差 ± 0.005

色度 & 色温对照表	
典型色温 (K)	色度区域
4750~5000	3T、3C、3D、3U
5000~5300	3S、3A、3B、3R
5300~5700	2T、2C、2D、2U
5700~6000	2S、2B、2A、2R
6000~6500	1T、1C、1D、1U
6500~7000	1S、1A、1B、1R
7000~8300	0A、0B、0C、0D、0R、0S、0T、0U
8300~10000	WA、WK

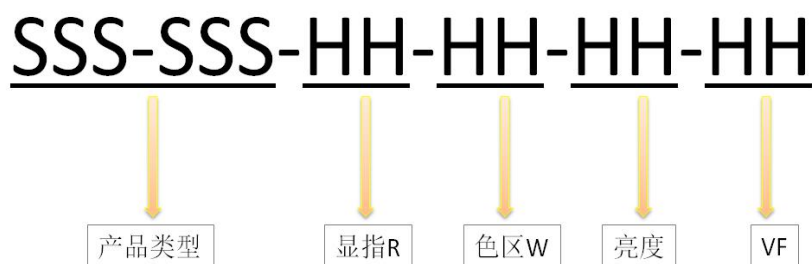
光电性能特征曲线 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$)





出货条码规则

下图为产品编码规则



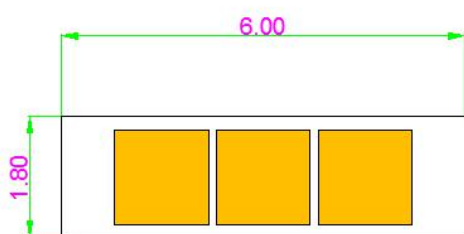
例如：LSGAWT-B0-1A-F4-VJ，其中 B0 表示显指；1A 表示色区，对应范围 6500-7000K；

F4 表示亮度，对应范围 730~780lm；VJ 表示正向电压，对应范围 9.1~9.4 V。

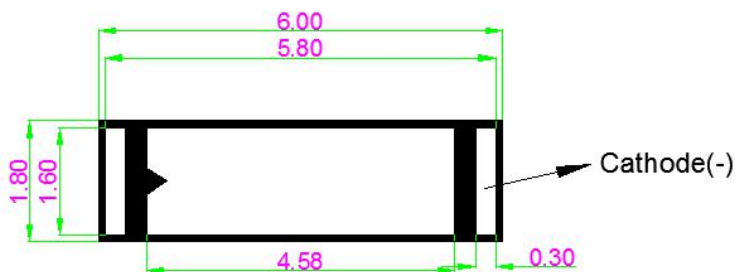
产品尺寸

单位: mm.

误差: ± 0.05



Top View



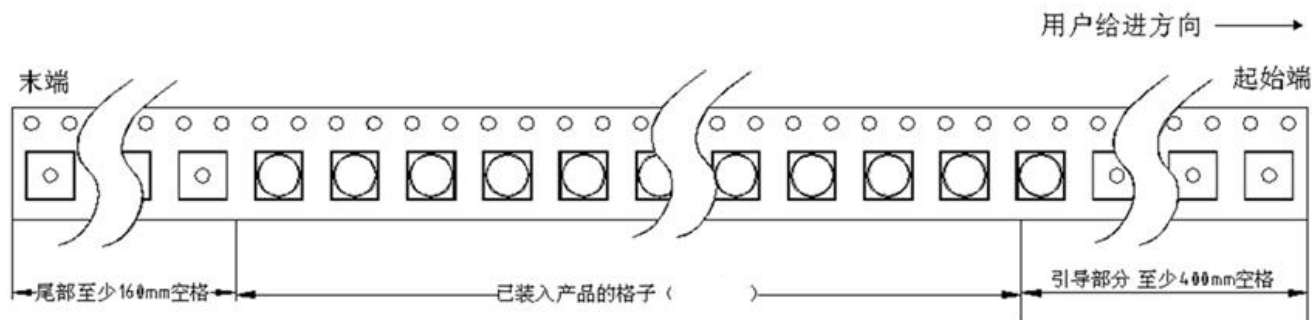
Bottom View

包装规格

包装方式: 7 英寸卷盘包装 (包装数量: 3000pcs)

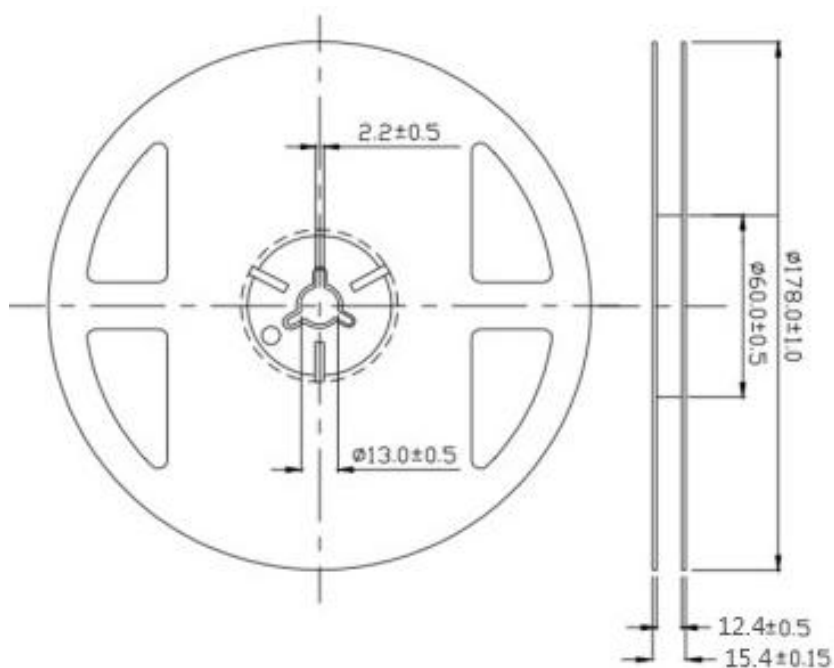
单位: mm

载带尺寸图

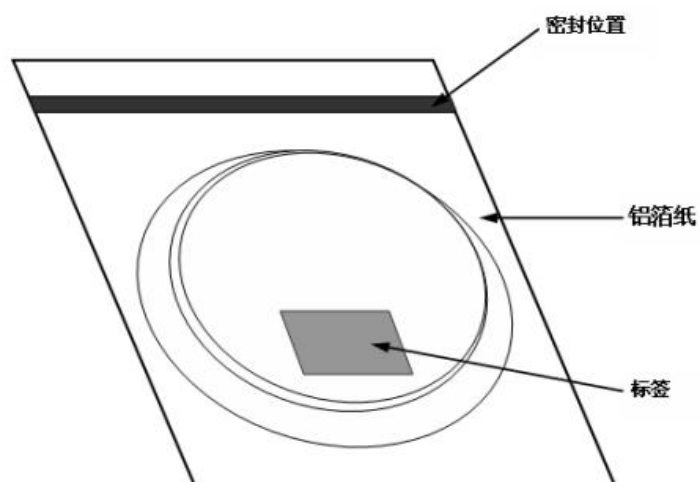


卷盘尺寸图

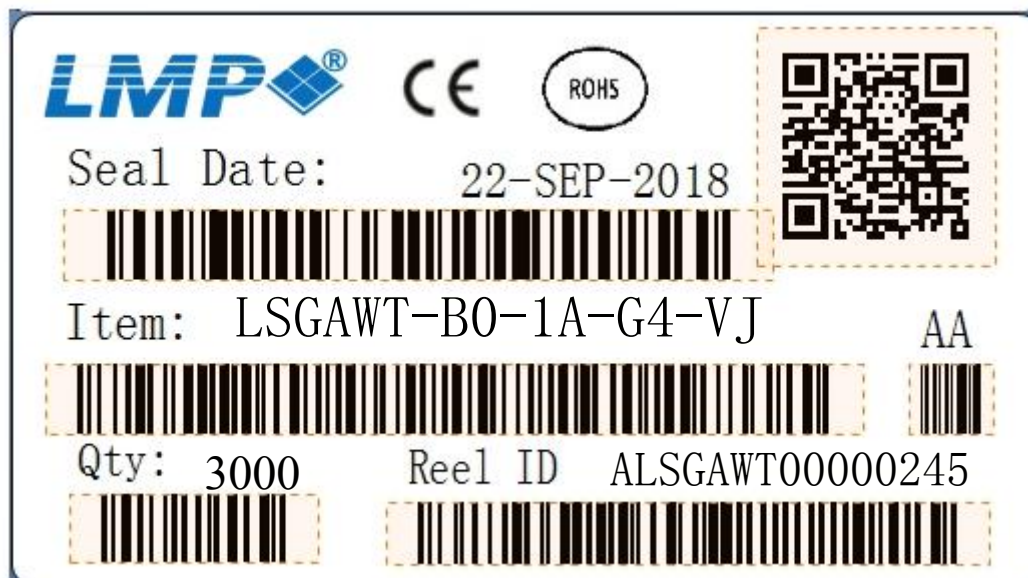
单位: mm



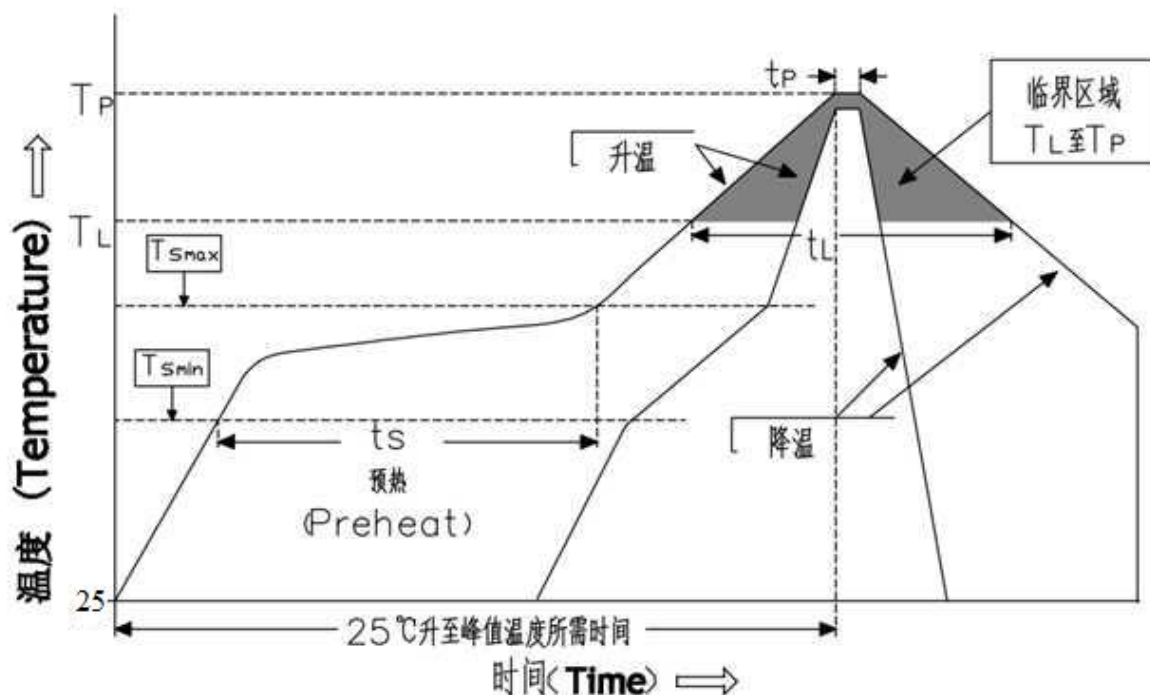
防潮包装



出货条码



回流焊升温曲线



分布特征	含铅回流焊	无铅回流焊
平均升温速度 ($T_{Smax}-T_p$)	3°C/second max.	3°C/second max.
最低预热温度 (T_{Smin})	100°C	150°C
最高预热温度 (T_{Smax})	150°C	200°C
预热时间 ($t_{Smin}-t_{Smax}$)	60~120 seconds	60~180 seconds
温度 (T_L)	183°C	217°C
维持在 T_L 以上的时间 (t_L)	60~150 seconds	60~150 seconds
峰值温度 (T_p)	215°C	260°C
维持与实际峰值温度相差在 5°C 以内的时间 (t_p)	10~30 seconds	20~40 seconds
降温速度	6°C/second max.	6°C/second max.
从 25°C 升至峰值温度所需时间	6 minutes max.	8 minutes max.

备注:

1. 所有温度指封装表面温度，为封装体表面测定的数据；
2. 本回流焊曲线提供参考，并非适用于所有的 PCB 设计和回流焊设备；
3. 其他事项请参考《使用注意事项》。

使用注意事项

一、储存

1. 储存温度 5~30℃,相对湿度小于 28%。
2. 避免外力破坏真空包装袋,以防受潮。

二、使用

1. 正品锡膏,标准自动贴片机贴装。
2. 八温区以上回流焊,峰值温度小于 260℃,时间小于 10s。
3. 重复回流焊不超过 2 次。
4. 杜绝对灯珠施力受压,以免透镜刮伤、变形或脱落,造成死灯。
- 5 禁止使用有机溶剂或超声波。
- 6.焊接面空洞率小于 20%。
- 7.冷却后方能测试及使用。
- 8.做好静电防护。